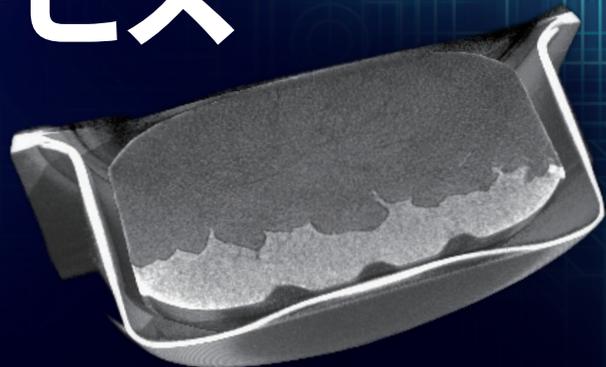


2018年4月スタート

非破壊分析サービス

MSTの受託分析ラインアップに、新たに非破壊分析サービスが登場。

樹脂やカーボン素材等、有機系の分析に強い装置を揃えました。医薬品を始め、半導体の故障解析など幅広い分野に対応します。



最新の加工・分析装置を導入しました

X線CT

X線照射により試料内部構造の二次元透過像を取得。試料を回転させた連続撮影データから、三次元CT画像を生成します。



超音波顕微鏡

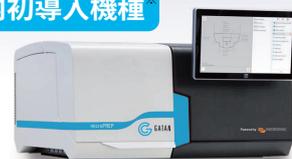
試料に超音波を照射し、その反射波を検出。超音波は空気層で強い反射を起こすため、試料内部の空隙やクラックの観察が可能です。



レーザー加工機

FIBに比べ10⁴倍の加工スピード。X線CT用試料の着目箇所以外を削る事で不要な部分の映り込みを無くし、鮮明なCT画像の取得が可能です。

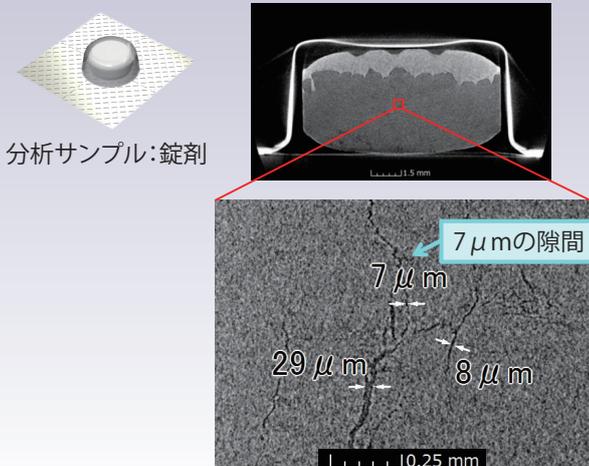
国内初導入機種*



*株式会社ナノテクノロジーソリューションズ調べ(2018年3月時点)

詳しい仕様は裏面をご覧ください》

解析例 1 X線CTによる 錠剤内部のイメージング分析



非破壊で錠剤内部の構造を可視化しました。内部に存在する隙間のサイズが確認できました。

解析例 2 X線CTによる GPUの非破壊3D形状観察

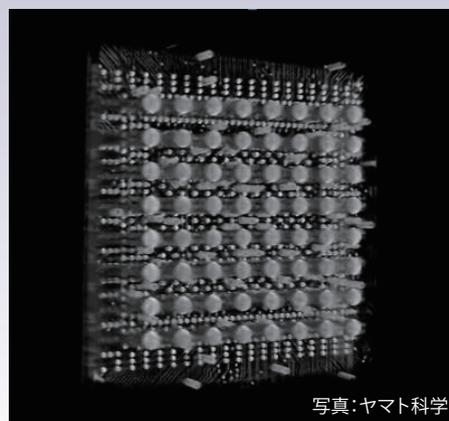


写真:ヤマト科学

パッケージを開封せず内部構造を観察しました。内部の電極構造を立体的に確認することができます。

仕様

SPECIFICATION

X線CT

管電圧	30~160(kV)
搭載可能サンプルサイズ、重量	Φ150mm×高さ150mm、2kg
最小ボクセル（空間分解能）	0.1μm

超音波顕微鏡

周波数	15~230(MHz)
搭載可能サンプルサイズ	308mm□（高さ5cmまで）
備考	水をかけ流しながら測定可能

料金

FEE

- ・X線CT : ￥100,000～ / 試料
- ・超音波顕微鏡 : ￥50,000～ / 試料

速報納期

DELIVERY DATE

- 通常7日
- ※即日対応も可

適用例

APPLICATION

電子デバイス関連

- ・半導体パッケージの内部ボイド、クラック、異物解析
- ・BGA実装品のはんだ剥離調査
- ・樹脂内部の空孔率の調査
- ・レーザー孔の形状調査

自動車部品・バッテリー関連

- ・ボディー等の溶接部観察/解析
- ・小型Liイオン電池の不良解析
- ・樹脂内フィラーの分散度観察
- ・樹脂成型品の繊維配向観察

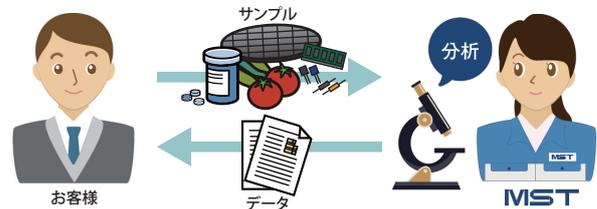
医薬品・医療機器関連

- ・錠剤の皮膜調査
- ・錠剤内部のクラック、ボイド、空孔解析
- ・カテーテル等の内径調査 etc.

ご依頼方法

HOW TO REQUEST

MSTは、お客様からお預かりした材料・製品の機器分析を承ります。



分析をご検討の際は、下記連絡先までまずはお問い合わせください。

専任の担当者が適切な分析プランをご提案します。



MST 材料科学技術振興財団

一般財団法人

分析のご相談・お申し込みは、TMG（受付部門）へ

TEL : 03-3749-2525 (東京) E-mail : info@mst.or.jp URL : http://www.mst.or.jp/

東京本部	〒157-0067	東京都世田谷区喜多見1-18-6	TEL : 03-3749-2525
大阪支所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9 新大阪フロントビル7F	TEL : 06-6392-2700
名古屋支所	〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8 いちご名古屋ビル3F	TEL : 052-586-2626
仙台支所	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル9F	TEL : 022-217-8288

ホームページに
詳細情報掲載中

てむぞう & ますみん

